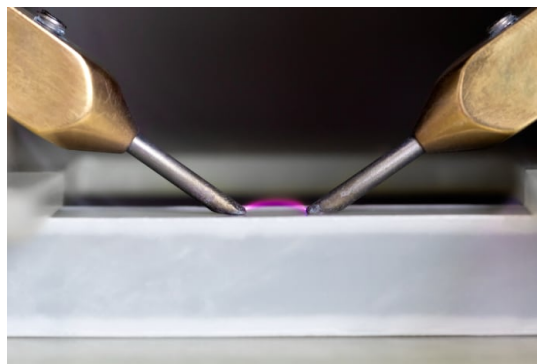


## Additivi e resine silconiche al JEC

Wacker lancia alla fiera parigina tre nuovi prodotti ad alte prestazioni per l'industria dei materiali compositi.

10 marzo 2026 08:42

Nuovi additivi per la modifica di materiali compositi e un compound, tutti a base silconica, vengono lanciati in questi giorni da Wacker a JEC World, la fiera internazionale di settore in programma fino al 12 marzo a Parigi.



Sotto i riflettori ci sono i due modificanti Genioperl W37 e Genioperl W38, formulati per migliorare le proprietà meccaniche di resine termoindurenti come epossidiche e vinilesteri, in particolare per quanto concerne la resistenza agli urti.

La loro struttura molecolare basata su un building block silconico funzionale favorisce la separazione di fase e forma domini elastomerici nanometrici nella matrice resinosa. Questi domini - spiega l'azienda tedesca - aumentano la tenacità della matrice e impediscono che il composito si rompa in caso di urto.

I due additivi si disperdono facilmente, sono compatibili con sistemi resinosi organici e funzionano in modo affidabile anche a bassi dosaggi. E per ridurre l'impatto ambientale, Wacker ha ridotto in modo significativo il contenuto di composti ciclici.

Genioperl W37 migliora la resistenza all'urto dei sistemi polimerici termoindurenti, in particolare nei range di bassa temperatura. In aggiunta, Genioperl W38 contiene additivi che riducono la formazione di schiuma, aspetto rilevante nei processi di colata caratterizzati da bassa pressione.

Wacker presenta a Parigi anche il compound silconico Powersil Resin 710 (in foto), idoneo per processi di stampaggio a compressione, iniezione e gelazione sotto pressione, in grado di resistere a temperature fino a 220 °C per manufatti in classe termica R. Viene proposto come alternativa ai tecnopolimeri resistenti alle alte temperature come PTFE e PEEK.

I componenti stampati con Powersil Resin 710 - sostiene il produttore - si distinguono per buone proprietà di isolamento elettrico, resistenza meccanica e stabilità ai raggi UV. Inoltre, la resina è priva di solventi e non è soggetta a obblighi di etichettatura.

Il materiale è disponibile sia in versione reticolabile con perossido per la produzione di

componenti finiti resistenti al calore, sia in una variante che reticola con piccole quantità di un catalizzatore siliconico standard.

© Polimerica - Riproduzione riservata